



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 111148403 B

(45) 授权公告日 2021.10.15

(21) 申请号 201911206233.6

H04M 1/02 (2006.01)

(22) 申请日 2015.06.04

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

JP 2007067279 A, 2007.03.15

申请公布号 CN 111148403 A

CN 102548365 A, 2012.07.04

CN 103052285 A, 2013.04.17

(43) 申请公布日 2020.05.12

CN 201557361 U, 2010.08.18

(62) 分案原申请数据

审查员 马菁京

201580063920.0 2015.06.04

(73) 专利权人 华为技术有限公司

地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

(72) 发明人 张治国 张迎春 甄海涛 康南波

(51) Int. Cl.

H05K 7/20 (2006.01)

H05K 9/00 (2006.01)

G06F 1/20 (2006.01)

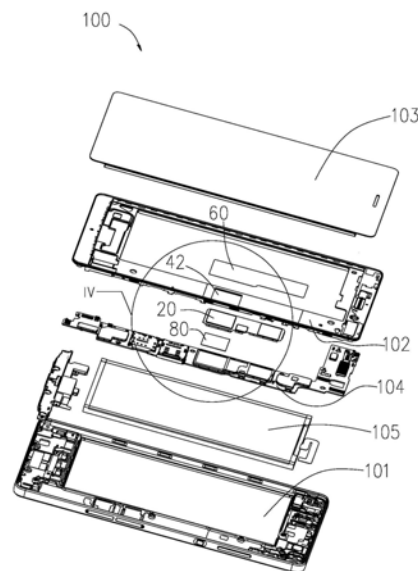
权利要求书1页 说明书7页 附图3页

(54) 发明名称

移动终端及散热屏蔽结构

(57) 摘要

一种移动终端,包括电路板、设于所述电路板上的发热元件、屏蔽罩及中框,所述屏蔽罩连接于所述电路板,并与所述电路板共同形成屏蔽空间,所述发热元件收容于所述屏蔽空间内,所述电路板设置于所述中框的一侧,所述中框设有收容空间,所述屏蔽罩包括相对设置的顶部和底部,所述底部用于与所述电路板连接,所述顶部位于所述发热元件上方且伸入所述收容空间。本发明还提供一种散热屏蔽结构。本发明利于移动终端及散热屏蔽结构的轻薄化。



1. 一种移动终端,包括散热板、显示屏和电路板,所述电路板安装于所述散热板的一侧,所述显示屏安装于所述散热板的另一侧;所述移动终端还包括导热体、设于所述电路板上的发热元件和屏蔽罩,所述屏蔽罩与所述电路板共同形成屏蔽空间,所述发热元件收容于所述屏蔽空间内,其特征在于,

所述散热板设有收容空间,所述收容空间呈通孔结构,所述屏蔽罩包括相对设置的顶部和底部,所述底部用于与所述电路板连接,所述顶部位于所述发热元件上方且伸入所述收容空间;

所述顶部包括顶面,所述散热板包括贴合面,所述导热体包括第一区域和第二区域,所述第一区域贴合于所述顶面,所述第二区域贴合于所述贴合面,所述散热板的材质为导热材质;

所述屏蔽罩还包括第一侧壁、第二侧壁和连接于所述第一侧壁和所述第二侧壁之间的肩部,所述第一侧壁连接于所述底部和所述肩部之间,所述第二侧壁连接于所述肩部和所述顶部之间,所述肩部未伸入所述收容空间。

2. 如权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述散热板与所述屏蔽罩的顶部直接或间接接触以使得所述发热元件所发出来的热通过所述屏蔽罩及所述散热板传导出。

3. 如权利要求1或2所述的移动终端,其特征在于,所述贴合面与所述屏蔽罩之所述顶面共面。

4. 如权利要求1或2所述的移动终端,其特征在于,所述导热体为石墨片或铜箔。

5. 如权利要求1或2所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端还包括导热胶,所述导热胶设于所述发热元件与所述屏蔽罩之顶部之间。

6. 如权利要求1或2所述的移动终端,其特征在于,所述顶部伸入所述收容空间的最大深度等于所述收容空间的深度。

7. 如权利要求2所述的移动终端,其特征在于,所述屏蔽罩通过导热介质与所述散热板接触。

8. 如权利要求1或2所述的移动终端,其特征在于,所述导热体是可弯折的。

9. 如权利要求1或2所述的移动终端,其特征在于,所述发热元件包括主芯片,电源管理芯片、存储芯片或射频芯片,其中,所述主芯片包括CPU和DDR。

移动终端及散热屏蔽结构

技术领域

[0001] 本发明涉及移动终端,尤其涉及移动终端的散热屏蔽结构。

背景技术

[0002] 随着移动终端的性能不断提高,移动终端的功耗不断增大,随着主芯片集成度增加,芯片功耗大而集中,芯片高度尺寸增加成为制约移动终端整体厚度设计的瓶颈。移动终端中需要使用屏蔽结构对主芯片进行电磁屏蔽。

[0003] 传统的屏蔽结构是通过屏蔽罩将主芯片罩在电路板上,再将电路板连同屏蔽罩安装于移动终端的中框,屏蔽罩的顶部与中框层叠设置,屏蔽罩与中框之间设置导热材料,以实现将主芯片发所出的热量传递出去。这种层叠设置的结构不利于移动终端的厚度的减小,不利于移动终端轻薄的发展方向。

发明内容

[0004] 本发明实施例提供了一种移动终端及散热屏蔽结构,能够实现有利于移动终端和散热屏蔽结构厚度减小,轻薄化的设计。

[0005] 一方面,本发明提供了一种移动终端,包括电路板、设于所述电路板上的发热元件、屏蔽罩及中框,所述屏蔽罩连接于所述电路板,并与所述电路板共同形成屏蔽空间,所述发热元件收容于所述屏蔽空间内,所述电路板设置于所述中框的一侧,所述中框设有收容空间,所述屏蔽罩包括相对设置的顶部和底部,所述底部用于与所述电路板连接,所述顶部位于所述发热元件上方且伸入所述收容空间。

[0006] 结合第一方面,在第一种可能的实施方式中,所述中框的材质为导热材质,所述中框与所述屏蔽罩的顶部直接或间接接触,以使得所述发热元件所发出来的热通过所述屏蔽罩及所述中框传导出。

[0007] 结合第一方面之第一种可能的实施方式,在第二种可能的实施方式中,所述中框包括第一表面和第二表面,所述第一表面面对所述屏蔽罩,所述第二表面与所述第一表面相背离设置,所述第二表面设有凹槽,所述移动终端还包括高导热体,所述高导热体设于所述凹槽内,所述高导热体贴合于所述中框。

[0008] 结合第一方面之第二种可能的实施方式,在第三种可能的实施方式中,所述收容空间呈通孔结构,所述顶部包括顶面,所述中框包括贴合面,所述贴合面位于所述凹槽的侧壁且与所述收容空间相邻,所述高导热体包括第一区域和第二区域,所述第一区域贴合于所述顶面,所述第二区域贴合于所述贴合面。

[0009] 结合第一方面之第三种可能的实施方式,在第四种可能的实施方式中,所述贴合面与所述屏蔽罩之所述顶面共面。

[0010] 结合第一方面之第三种可能的实施方式,在第五种可能的实施方式中,所述高导热体为石墨片或铜箔。

[0011] 结合第一方面之第三种可能的实施方式,在第六种可能的实施方式中,所述移动

终端还包括导热胶,所述导热胶设于所述发热元件与所述屏蔽罩之顶部之间。

[0012] 结合第一方面之第三种可能的实施方式,在第七种可能的实施方式中,所述屏蔽罩还包括第一侧壁、第二侧壁和连接于所述第一侧壁和所述第二侧壁之间的肩部,所述第一侧壁连接于所述底部和所述肩部之间,所述第二侧壁连接于所述肩部和所述顶部之间,所述顶部相对所述肩部形成“凸”状结构。

[0013] 另一方面,本发明提供了一种散热屏蔽结构,所述散热屏蔽结构包括屏蔽罩和散热板,所述屏蔽罩用于与电路板连接并与所述电路板共同形成屏蔽空间,所述屏蔽空间内设发热元件,所述屏蔽罩包括相对设置的顶部和底部,所述底部用于与所述电路板连接,所述顶部位于所述发热元件上方,所述散热板设有收容空间,所述屏蔽罩之所述顶部伸入所述收容空间中。

[0014] 结合第二方面,在第一种可能的实施方式中,所述散热板包括第一表面和第二表面,所述第一表面面对所述屏蔽罩,所述第二表面与所述第一表面相背离设置,所述第二表面设有凹槽,所述散热屏蔽结构还包括高导热体,所述高导热体设于所述凹槽内,所述高导热体贴合于所述散热板。

[0015] 结合第二方面之第一种可能的实施方式,在第二种可能的实施方式中,所述收容空间呈通孔结构,所述顶部包括顶面,所述中框包括贴合面,所述贴合面位于所述凹槽的底壁且与所述收容空间相邻,所述高导热体包括第一区域和第二区域,所述第一区域贴合于所述顶面,所述第二区域贴合于所述贴合面。

[0016] 结合第二方面之第二种可能的实施方式,在第三种可能的实施方式中,所述贴合面与所述屏蔽罩之所述顶面共面。

[0017] 结合第二方面之第三种可能的实施方式,在第四种可能的实施方式中,所述高导热体为石墨片或铜箔。

[0018] 结合第二方面之第四种可能的实施方式,在第五种可能的实施方式中,所述散热板的材质为高导热金属材质。

[0019] 结合第二方面之第四种可能的实施方式,在第六种可能的实施方式中,所述散热屏蔽结构还包括导热胶,所述导热胶设于所述发热元件与所述屏蔽罩之顶部之间。

[0020] 结合第二方面之第四种可能的实施方式,在第七种可能的实施方式中,所述屏蔽罩还包括第一侧壁、第二侧壁和连接于所述第一侧壁和所述第二侧壁之间的肩部,所述第一侧壁连接于所述底部和所述肩部之间,所述第二侧壁连接于所述肩部和所述顶部之间,所述顶部相对所述肩部形成“凸”状结构。

[0021] 相较于现有技术,本发明提供的移动终端和散热屏蔽结构,通过在中框和散热板上设收容空间,并将屏蔽罩的顶部伸入收容空间中,有利于移动终端和散热屏蔽结构厚度减小,有利于轻薄化的发展。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

- [0023] 图1为本发明一种实施方式中移动终端的立体分解的示意图。
- [0024] 图2为本发明的移动终端部分截面示意图。
- [0025] 图3为图2中III部分的放大示意图。
- [0026] 图4为图1中IV部分的放大示意图。
- [0027] 图5为本发明一种实施方式提供的移动终端的平面示意图。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0029] 本发明提供一种移动终端和一种散热屏蔽结构,图1至图5均可以用于辅助说明移动终端的结构和散热屏蔽结构,散热屏蔽结构中的散热板可以为移动终端中的中框或者中框的一部分。在第一种实施例(即移动终端)的描述部分中,参照图1至图5,中框用标号102表达。在第二种实施例(即散热屏蔽结构)的描述部分中,也参照图1至图5,散热板也用标号102来表达。这样,在图中,散热板和中框部分的标号都是102,但下文实施例的描述中,分别用中框和散热板表达,以区分两个实施例。详述如下。

[0030] 本发明一种实施方式提供的移动终端,移动终端可以为手机或平板。请参阅图1和图2,移动终端100包括后壳101、中框102、显示屏103、电路板104及电池105,所述电路板104及电池105安装于所述中框102的一侧,显示屏103安装于所述中框102的另一侧,电路板104和电池105收容于后壳101内。电路板104上设有发热元件1042(如图2所示),例如,发热元件1042可以为移动终端100的主芯片,主芯片包括CPU和叠放在CPU上方的DDR,发热元件1042也可以为其它芯片(例如:电源管理芯片、存储芯片、射频芯片等),由于主芯片集成了多功能,主芯片的厚度大于其它芯片。

[0031] 所述移动终端100还包括屏蔽罩20,所述屏蔽罩20连接于所述电路板104,并与所述电路板104共同形成屏蔽空间,所述发热元件1042收容于所述屏蔽空间内,所述中框102设有收容空间42,所述屏蔽罩20包括相对设置的顶部21和底部22,所述底部22用于与所述电路板104连接,所述顶部21位于所述发热元件1042上方且伸入所述收容空间42。

[0032] 需要说明的是,所述顶部21伸入所述收容空间42的最大深度等于所述收容空间42的深度。

[0033] 本发明通过将所述移动终端100中的屏蔽罩20的顶部21伸入中框102的收容空间42中,也就是说,在中框102中挖出收容空间42,安装过程中,屏蔽罩20的顶部21收容在收容空间42内。这样的结构,有利于移动终端100朝向轻薄化的发展,不但厚度得到了减小,重量也可以减轻。

[0034] 具体而言,所述中框102的材质为导热材质,所述中框102与所述屏蔽罩20的顶部21直接或间接接触,以使得所述发热元件所发出来的热通过所述屏蔽罩20及所述中框102传导出去,这样,有利于对所述发热元件的散热。屏蔽罩20与中框102之间可以直接接触,屏蔽罩20的热直接传递至中框,屏蔽罩20与中框102之间也可以通过其它导热介质接触,以提升导热效率,例如通过导热胶或者其它的导热体实现屏蔽罩20与中框102的间接接

触。

[0035] 请参阅图3,所述中框102包括第一表面41和第二表面43,所述第一表面41面对所述屏蔽罩,所述第二表面43与所述第一表面41相背离设置,所述第二表面43设有凹槽(未图示),即,中框102上设有凹槽,所述凹槽形成在所述第二表面43,也就是在第二表面43上挖出所述凹槽。所述移动终端100还包括高导热体60,所述高导热体60设于所述凹槽内,所述高导热体60贴合于所述中框102。这样的结构,相当于将高导热体60嵌入中框102中,从而,可以达到更好的散热效果。

[0036] 一种实施方式中,所述高导热体60为石墨片或铜箔。

[0037] 一种实施方式中,请参阅图2和图3,所述收容空间42呈通孔结构,所述顶部21包括顶面212,所述中框102包括贴合面44,所述高导热体60包括第一区域62和第二区域64,所述第一区域62贴合于所述顶面212,所述第二区域64贴合于所述贴合面44。所述收容空间42位于所述第二表面上的所述凹槽的底壁且与所述凹槽相通,所述贴合面44位于所述凹槽的底壁且与所述收容空间42相邻。

[0038] 进一步而言,所述贴合面44与所述屏蔽罩之所述顶面212共面。将所述高导热体60安装在所述凹槽内,高导热体60的表面与中框102的表面共面,从而,在移动终端整机厚度不变的情况下,可达到更好的散热效果。而且共面的结构,使得中框102整体平整,在组装移动终端的过程中,可以减小安装间隙,从而,有利于减小移动终端100的整机厚度。

[0039] 一种实施方式中,高导热体60具有可弯折的特性,高导热体60穿过收容空间42,位于收容空间42一侧的高导热体60的部分贴合于屏蔽罩20的顶面212,位于收容空间42另一侧的高导热体60的部分贴合于中框102之面对电路板104一侧的表面。换言之,高导热体60穿过收容空间42(收容空间42呈通孔状),部分高导热体位于中框102的一侧,部分高导热体位于中框102的另一侧。

[0040] 其它实施方式中,收容空间42也可以为盲孔(或者为凹槽)的结构,也就是保留一部分中框102,收容空间42的内部形成一个底壁,此底壁与屏蔽罩20的顶部21相接触。

[0041] 需要说明的是,当移动终端中使用一个屏蔽罩20将一个或多个发热元件1042罩在电路板104上,可以在所述中框102上设计一个收容空间42(屏蔽罩的高度与所罩的发热元件的最大高度有关),所述一个收容空间42的尺寸与所述一个屏蔽罩20的顶部21的尺寸相匹配;当移动终端中使用多个屏蔽罩20将多个发热元件罩在电路板104上,可以根据不同高度的屏蔽罩20(屏蔽罩的高度与所罩的发热元件的最大高度有关),在所述中框102上设计不同深度的多个收容空间42,所述多个收容空间42的尺寸与所述多个屏蔽罩20的尺寸相匹配,从而,完成移动终端的组装时,所述中框、所述屏蔽罩和所述电路板可以刚好吻合的扣合在一起。

[0042] 请参阅图2和图3,所述移动终端100还包括导热胶80,所述导热胶80设于所述发热元件1042与所述屏蔽罩20之顶部21之间。

[0043] 请参阅图2,所述屏蔽罩20还包括第一侧壁23、第二侧壁24和肩部25,所述第一侧壁23连接于所述底部22和所述肩部25之间,所述第二侧壁24连接于所述肩部25和所述顶部21之间,所述屏蔽罩20形成“凸”状结构。屏蔽罩20的这种“凸”状结构使得屏蔽罩20可以屏蔽不同高度的芯片。

[0044] 请参阅图5,图5所示为本发明一种实施方式提供的移动终端的平面示意图(仅示

出与屏蔽罩20和中框102相关的部分),图5中,屏蔽罩20的顶部21伸入中框102的收容空间42中,高导热体60收容在中框102的凹槽内,高导热体60与中框102共同形成具有平整的表面的整体,由于屏蔽罩20的顶部21伸入收容空间42内,这样,在厚度方向上,屏蔽罩20与中框102就有一部分重合的区域,也就是屏蔽罩20的顶部21伸入收容空间42内的厚度方向的尺寸H,也就是收容空间42的高度H,这样,就使得移动终端整体的厚度可以得到降低,有利于移动终端的轻薄化发展。

[0045] 本发明还提供了一种散热屏蔽结构,所述散热屏蔽结构可以应用在移动终端100中,散热屏蔽结构也可以应用在其它的电子产品中,例如机顶盒、路由器等家用或机房用电子产品,只要在电子产品中包括需要进行电磁屏蔽的芯片,均可以使用本发明提供的散热屏蔽结构。以下对散热屏蔽结构的描述中,同样对应图1至图5,但移动终端中的中框102更名为散热板102,在散热屏蔽结构中,以散热板命名更合适,因为散热板可以独立于中框存在,也可以成为中框的一部分,在移动终端中,也可以将中框视为散热板,虽然名称不同,但意思表达并不矛盾。

[0046] 请参阅图1至图4,散热屏蔽结构包括屏蔽罩20、散热板102和高导热体60。

[0047] 请参阅图1和图2,所述屏蔽罩20用于与电路板104连接,且与电路板104共同形成屏蔽空间,电路板104上的发热元件1042收容于屏蔽空间中。所述屏蔽罩20包括相对设置的顶部21和底部22,所述底部22与所述电路板104连接,所述顶部21位于所述发热元件1042上方。屏蔽罩20的底部22与电路板104之间可以通过焊接固定,也可以通过卡扣的方式固定,例如在屏蔽罩20的底部22设卡扣,在电路板104上设扣孔,将卡扣与扣孔配合,从而可以将屏蔽罩20固定在电路板104上。

[0048] 本实施方式中,当散热屏蔽结构应用于移动终端100时,散热板102一体成型于移动终端100的中框102,也就是说散热板102是中框102的一部分。其它实施方式中,散热板102也可以分离于中框102,将散热板102通过粘胶或锁螺丝等方式固定于中框102。将散热板102与中框102选择不同的材质,使得整体的散热性能提高,这样散热板102可以选择成本较高,但散热性能好的高导热材料,中框102选择一般的金属材料,由于散热板102离发热元件1042近,能够依靠其高导热性能将发热元件1042的热快速传递至中框102,再由中框102向外散热。

[0049] 请参阅图2和图3,所述散热板102设有收容空间42,所述屏蔽罩20之所述顶部21伸入所述收容空间42中,所述顶部21包括顶面212,顶面设于屏蔽罩20的顶部21之远离发热元件1042的一侧,也就是屏蔽罩20的外表面的一部分。所述散热板102包括贴合面44,所述高导热体60包括第一区域62和第二区域64,所述第一区域62贴合于所述屏蔽罩20之顶面212,所述第二区域64贴合于所述贴合面44。这样通过高导热体60将屏蔽罩20与散热板102连接在一起,所述高导热体60为石墨片或铜箔,通过导热胶80将高导热体60与屏蔽罩20和散热板102连接在一起。本实施方式中,散热板102呈板状,高导热体60呈薄片状。

[0050] 本发明提供的散热屏蔽结构,通过在散热板102上设收容空间42,并将屏蔽罩20的顶部21伸入收容空间42中,有利于减小散热屏蔽结构的尺寸,有利于移动终端100轻薄化的发展。

[0051] 一种实施方式中,请参阅图3,所述散热板102包括第一表面41和第二表面43,所述第一表面41面对所述屏蔽罩20,所述第二表面43与所述第一表面41相背离设置,散热板102

设有凹槽(未图示),所述凹槽形成在所述第二表面43,也就是在第二表面43上挖出所述凹槽。所述贴合面44位于所述凹槽的底壁,高导热体60收容在凹槽中,使得高导热体60与散热板102结合后,高导热体60与散热板102齐平,亦即,高导热体60的尺寸与散热板102上的凹槽的尺寸相匹配。

[0052] 一种实施方式中,收容空间42呈通孔状结构,所述收容空间42与所述凹槽相通,具体的制作过程中,在凹槽底壁的位置处打通孔形成所述收容空间42。高导热体60作为屏蔽罩20和散热板102之间的连接件,也就是说屏蔽罩20与散热板102之间通过高导热体60间接接触,高导热体60用于在屏蔽罩20和散热板102进行导热。

[0053] 其它实施方式中,收容空间42也可以设计为盲孔或凹槽的结构,这种情况下,可以不使用高导热体60,将散热板102与屏蔽罩20直接接触。或者将高导热体60贴附在散热板102表面,使得高导热体60与屏蔽罩20分别位于散热板102的两侧。

[0054] 一种实施方式中,高导热体60具有可弯折的特性,高导热体60穿过收容空间42,位于收容空间42一侧的高导热体60的部分贴合于屏蔽罩20的顶面212,位于收容空间42另一侧的高导热体60的部分贴合于散热板102之面对电路板104一侧的表面。换言之,高导热体60穿过收容空间42(收容空间42呈通孔状),部分高导热体位于散热板102的一侧,部分高导热体位于散热板的另一侧。

[0055] 通过高导热体60贴合屏蔽罩20的顶部21和散热板102的贴合面44,实现将电路板104上的发热元件1042所发出的热传导出至散热板102,使得所述散热屏蔽结构具有好的散热性能。

[0056] 为了加强散热屏蔽结构的散热性能,散热板102的材质可选择高导热金属材料。

[0057] 本发明实施例之所述散热屏蔽结构还包括导热胶80,所述导热胶80设于所述发热元件1042与所述屏蔽罩20之顶部21之间,导热胶80用于将发热元件1042的热传递至屏蔽罩20,屏蔽罩20为可以金属导热材质制成,提高散热能力。

[0058] 请参阅图2,所述屏蔽罩20还包括第一侧壁23、第二侧壁24和连接于所述第一侧壁23和所述第二侧壁24之间的肩部25,所述第一侧壁23连接于所述底部22和所述肩部25之间,所述第二侧壁24连接于所述肩部25和所述顶部21之间,所述顶部21相对所述肩部25形成“凸”状结构。屏蔽罩20的这种“凸”状结构使得屏蔽罩20可以屏蔽不同高度的芯片。

[0059] 需要说明的是,当使用一个屏蔽罩20将一个或多个发热元件1042罩在电路板104上,可以在所述散热板102上设计一个收容空间42(屏蔽罩的高度与所罩的发热元件的最大高度有关),所述一个收容空间42的尺寸与所述一个屏蔽罩20的顶部21的尺寸相匹配;当使用多个屏蔽罩20将多个发热元件1042罩在电路板104上,可以根据不同高度的屏蔽罩20(屏蔽罩的高度与所罩的发热元件的最大高度有关),在所述散热板102上设计不同深度的多个收容空间42,所述多个收容空间42的尺寸与所述多个屏蔽罩20的顶部21的尺寸相匹配,从而,所述散热板102、所述屏蔽罩20和所述电路板102可以刚好吻合的扣合在一起。

[0060] 所述散热屏蔽结构可以直接应用于移动终端中,将所述散热屏蔽结构应用于所述移动终端中时,所述散热板为中框的一部分,也就是直接将中框作为散热板,为发热芯片提供散热,不但增加了中框的功能,在原本的安装定位功能的基础上增加了散热功能,还有利于减小移动终端的厚度。请参阅图5,图5所示为本发明一种实施方式提供的散热屏蔽结构的平面示意图,图5中,屏蔽罩20的顶部21伸入散热板102的收容空间42中,高导热体60收容

在散热板42的凹槽内,高导热体60与散热板102共同形成具有平整的表面的整体,由于屏蔽罩20的顶部21伸入收容空间42内,这样,在厚度方向上,屏蔽罩20与散热板102就有一部分重合的区域,也就是屏蔽罩20的顶部21伸入收容空间42内的厚度方向的尺寸H,也就是收容空间42的高度H,这样,就使得散热屏蔽结构整体的厚度可以得到降低,有利于移动终端的轻薄化发展。

[0061] 以上对本发明实施例所提供的一种散热屏蔽结构和移动终端进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

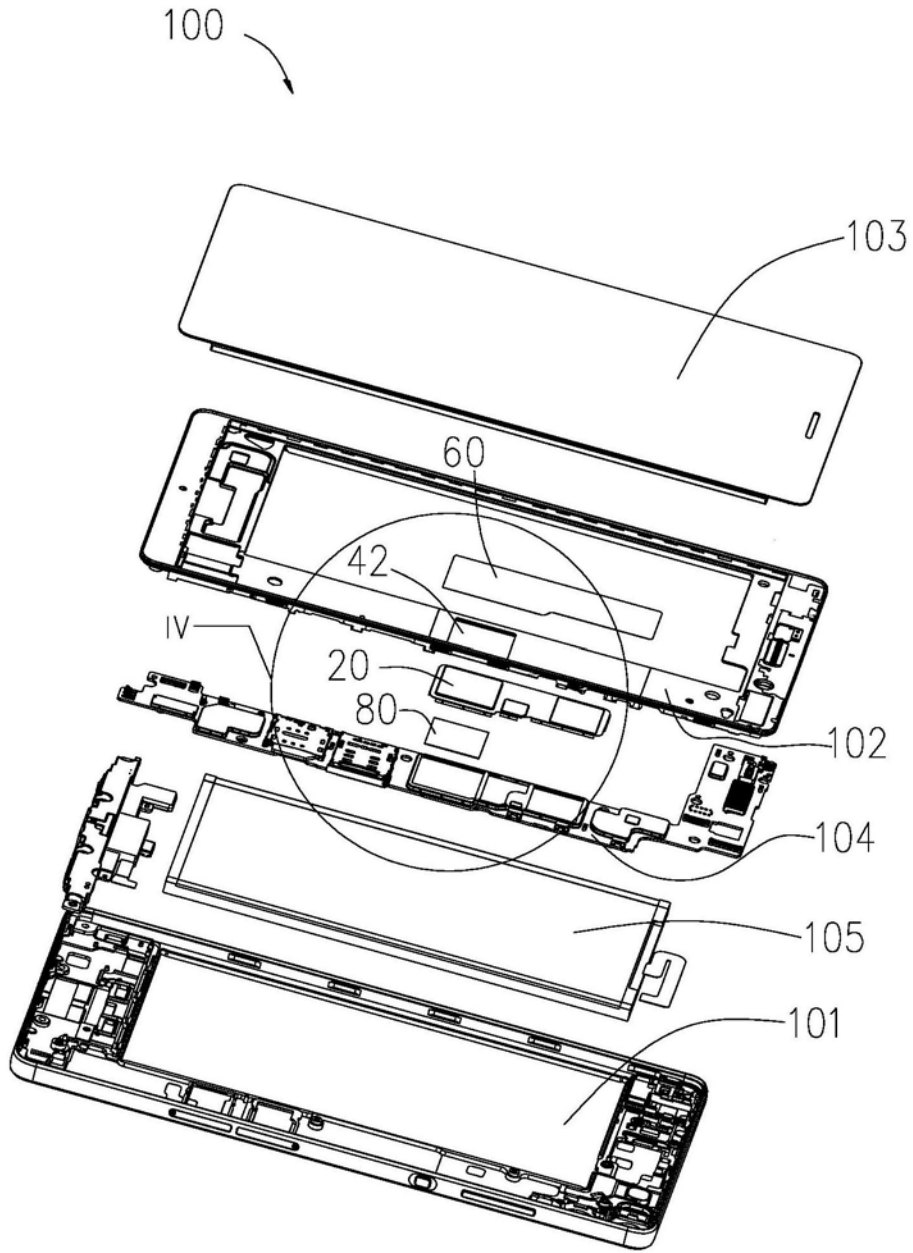


图1

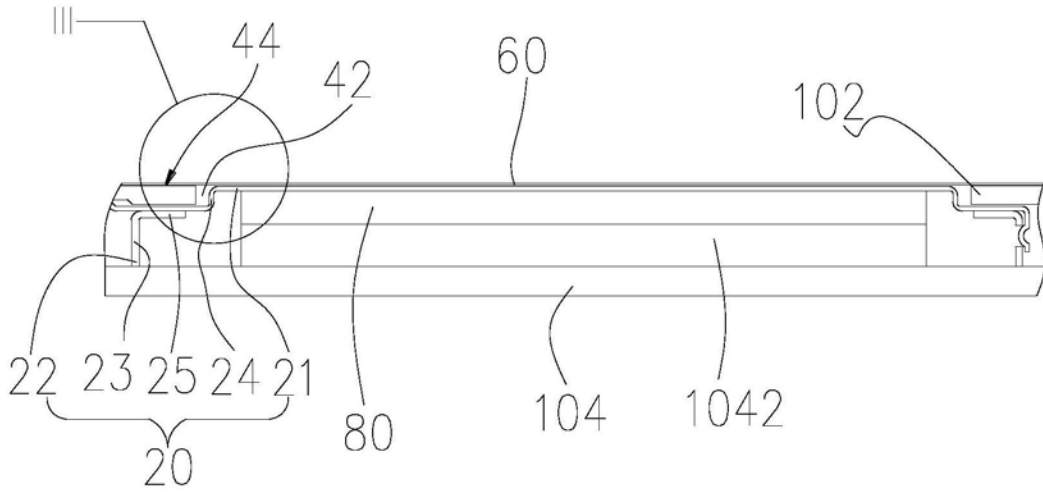


图2

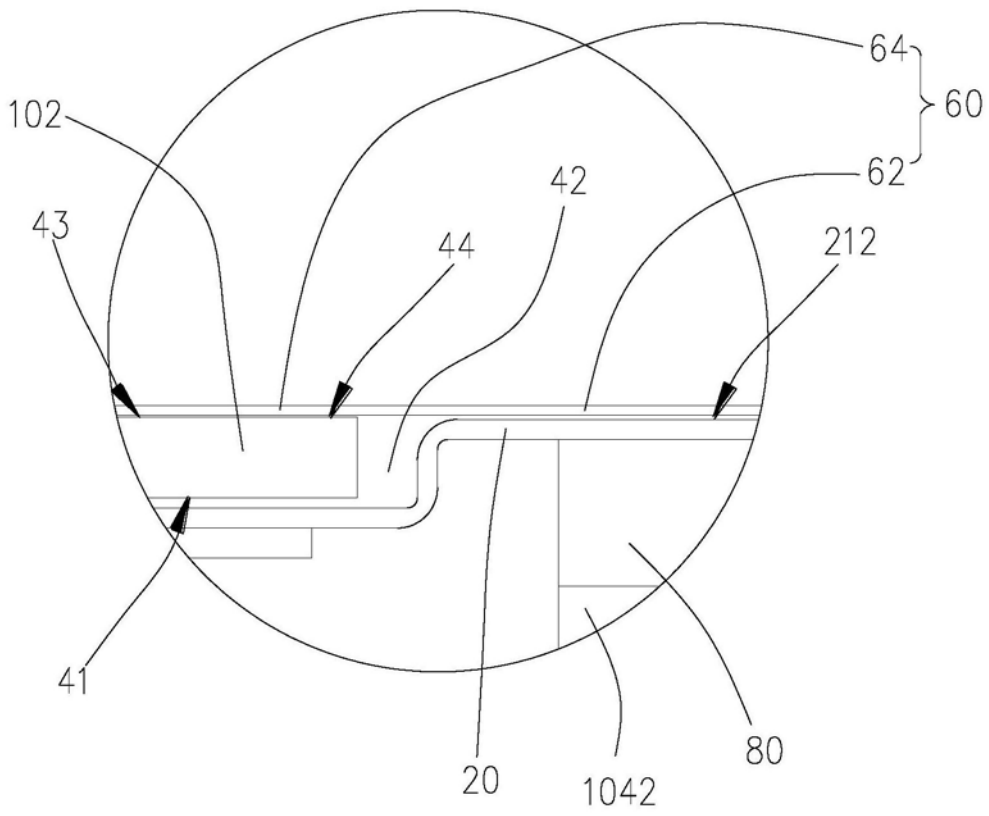


图3

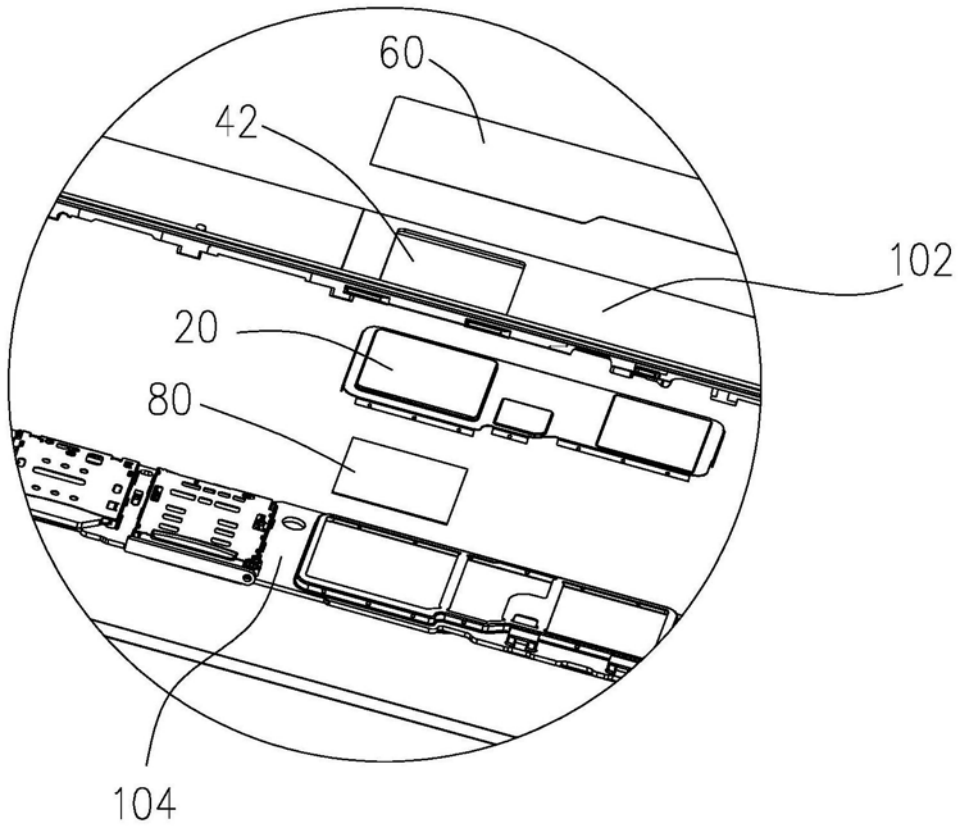


图4

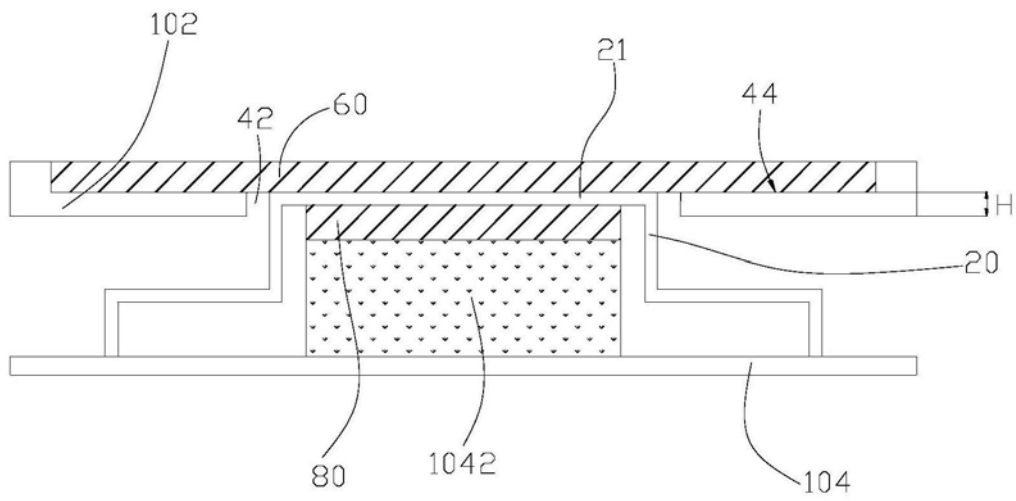


图5